

2015 年 8 月 26 日

高速・高精度フリップチップボンダ YSB55w 発表

株式会社新川（社長：長野高志、東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番地の 1）は、ヤマハ発動機株式会社が開発した高速・高精度フリップチップボンダ「YSB55w」を、2015 年 12 月より発売します。

近年、スマートフォンやウェアラブル機器市場において、半導体の生産規模拡大が進んでいます。中でも、各種デバイスモジュールの小型化・薄型化・低消費電力化・高機能化を可能とするフリップチップパッケージの採用が拡大しており、これまで以上に高生産性・高精度フリップチップボンディングに対する要求が高まっています。

「YSB55w」は、そのような市場ニーズに応えるべく、高剛性フレームにデュアルボンディングヘッドや新開発の高分解能チップ認識カメラを装備し、高生産性と高精度を追求した新モデルです。従来のボンダに比し約 3 倍の高生産性と、業界トップクラスの高精度を実現する能力を併せ持った装置となっています。

【YSB55w の特長】

- (1) 業界トップレベルの 13,000UPH（＊）（プロセス時間を含む最適条件時）という高速実装を実現
- (2) 新開発の高分解能チップ認識カメラの搭載により実装精度 $\pm 5\mu\text{m}$ （3 σ ）を実現
- (3) 高精度な荷重制御を行う、小型ヘッドを採用
- (4) 2~30mm の幅広いチップサイズに対応
- (5) 設定変更が容易な転写ユニット

＊UPH： Unit Per Hour



【YSB55w】

「YSB55w」は、Taipei Nangang Exhibition Centerで開催されるSEMICON Taiwan 2015（2015年9月2日から4日まで開催）に出展します。

■ その他当社取扱製品

ワイヤボンダ、ダイボンダ

■ お問い合わせ先

お客様お問い合わせ担当：グローバル営業統括部 志村 達也（TEL：042-560-1168）

報道機関お問い合わせ担当：経営企画部 森 琢也（TEL：042-560-4848）

以上